



1. Internationales Kolloquium „LTCC RF- and Microsystem Interconnect“ in Ilmenau

Am 29. und 30. November hatte die Nachwuchsgruppe *Funktionalisierte Peripherik* der TU Ilmenau zum 1. Internationalen Kolloquium *LTCC RF- and Microsystem Interconnect* geladen. Das Programm wurde neben den Forschern der Ilmenauer Gruppe durch weitere Referenten aus dem In- und Ausland gestaltet. Ein inhaltlicher Schwerpunkt bezog sich auf die Anforderungen und Realisierungsmöglichkeiten von mikroelektronischen Schaltungen für höchste Frequenzen. Sie ermöglichen neue Anwendungen in der drahtlosen Telekommunikation, der Satellitentechnik bzw. sind bei modernen Abstandswarnsystemen in Autos erforderlich.

Neben dem Austausch der Ergebnisse aus Entwicklung und Forschung sollte das Kolloquium insbesondere auch den Dialog zwischen Universitäten und der Industrie fördern. Die Ilmenauer Forschungsgruppe strebt eine enge Verzahnung mit den Unternehmen in der Region bzw. bundesweit an und hofft mit dieser Veranstaltung, diese Kontakte zu intensivieren.

Die Gruppe *Funktionalisierte Peripherik* gehört neben der Nachwuchsforschergruppe *Mikrofluidik und Biosensorik*

zu einem von sechs vom *Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)* ausgewählten *Zentren für Innovationskompetenz* in den neuen Ländern. Diese Zentren wurden im Rahmen der *Innovationsoffensive Unternehmen Region* geschaffen, um regionale Forschungsschwerpunkte zu stärken. Im Ilmenauer Zentrum mit dem Namen *MacroNano* arbeiten gegenwärtig 16 wissenschaftliche und technische Mitarbeiter.

Ergänzend zu dem eineinhalbtägigen Programm des Kolloquiums wurde das halbtägige Abschlussseminar zum *BMBF-Projekt KERAMIS (Keramische Schaltungen für die Satellitenkommunikation)* durchgeführt. Mehrere Fachgebiete der *TU Ilmenau* waren an diesem dreijährigen Verbundvorhaben mit Industriebeteiligung vertreten. Erfreulich ist, dass dieses Programm mit der Unterstützung des *BMBF* und des *Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR)* eine Fortsetzung in *KERAMIS 2* findet, an dessen Ende eine technologische Erprobung in einem Satelliten steht. Von Ilmenauer Seite arbeiten die Fachgebiete *Hochfrequenz- und Mikrowellentechnik* und *Elektroniktechnologie* sowie die Nachwuchsforschungsgruppe *Funktionalisierte Peripherik* gemeinsam an der Lösung der Aufgaben.

Advanced Packaging Conference – Call for Papers

SEMI und *IMAPS Europe* veranstalten auch in diesem Jahr gemeinsam die *Advanced Packaging Conference* im Rahmen der *SEMICON* in Stuttgart. Die Veranstaltung wird unter dem Motto *Innovative and Cost-efficient Advanced Packaging* stehen.

Als Termin für die Konferenz wurde der 10. und 11. Oktober gewählt, so dass eine große zeitliche Nähe zur deutschen *IMAPS-Konferenz* (8./9. Oktober) in München besteht.

Die Veranstalter bitten um Einsendung von Abstracts zu folgenden Themen:

New Technologies, Challenges and Opportunities

- Wafer Level Packaging, Chip Scale Packaging, Bumping, Ball Grid Technologies



Die Teilnehmer des Kolloquiums (Quelle: B. Wegner, TU Ilmenau)

- Wafer Level Integration, System in Package (SiP), Heterogeneous 3D Packaging
 - Market/ Application drivers, Roadmaps, Supply chain
 - Chip / Package Co-Design, Concurrent engineering
- Advanced Manufacturing Technologies*
- New Processes, Tools and Materials
 - New approaches in testing (Reliability, Validation, Test and Failure Analysis Techniques)
 - Cost Management, Cost of Ownership, Supplier-Customer improvement programs.
 - Carriers and Substrates, Silicon Interposer

Die **Deadline** für Abstracts ist der **30. März 2007**. Die Bestätigung für die ausgewählten Beiträge erfolgt dann bis zum 30. Mai. Die Abstracts sollten folgenden Anforderungen genügen und per e-mail an europrograms@semi.org geschickt werden:

- maximal 400-600 Worte für Titel und Text
- Biographie des Autors (100 Worte)
- Kontaktdaten des Autors (Titel, Unternehmen, Adresse, Tel., Fax, e-mail, URL von Webangeboten des Unternehmens)
- Einzelheiten zu Kontaktpersonen (falls nicht mit dem Autor identisch)
- Key words
- In der „Subject“-Zeile der e-mail bitte *Advanced Packaging Conference* angeben.

www.semi.org/semiconueuropa

CICMT 2007 in Denver

IMAPS N.A. und die American Ceramic Society (ACerS) veranstalten in der Zeit vom 23. bis 26. April die *3rd International Conference and Exhibition on Ceramic Interconnect and Ceramic Microsystems Technologies (CICMT)*. Veranstaltungsort ist das Grand Hyatt Hotel in Denver/ Colorado.

Das wissenschaftliche Programm umfasst 60 Beiträge in folgenden Vortragsreihen:

- Materials and Processes for Microsystems
- Co-Firing Processes and Dimensional Control in LTCC
- High Frequency Characterization and Simulation
- Ceramic Actuators
- Advanced Packaging Technology
- Direct Write Technology
- International Session on Microsystems
- Microsystem Applications
- Processing and Design of Integrated Passives in LTCC
- Microsystem Materials and Processes
- Design and Fabrication of Ceramic Microsystems and Devices

Außerdem finden eine Postersession und eine Tabletop-Ausstellung statt. Die Plenarvorträge befassen sich mit der Anwendung von MEMS für die molekularmedizinische Diagnose, mit mikrofluidischen Mikrosystemen sowie mit Terabit-WLANs.

Für Interessenten: **Deadline** für die Registrierung zu **reduzierten Teilnehmergebühren** ist der **23. März**.

Das vollständige wissenschaftliche Programm ist unter: www.cicmt.org einsehbar.

Noch zu haben: Proceedings

Die Proceedings des *Deutschen IMAPS-Seminars 2006*, das am 9. Februar 2006 in Göppingen zum Thema *Muss jeder Sensor smart sein?* stattfand, können auf CD zum Preis von



€ 55,-

Veranstaltungskalender

Ort	Zeitraum	Name	Veranstalter
Daventry, Northampton, UK	6./7.3.2007	MicroTech Conference 2007	iMAPS UK
Denver, Colorado	23./26.4.2007	IMAPS / ACerS 3. Konferenz für CICMT (Ceramic Interconnect and Ceramic Microsystems Technology)	IMAPS Nordamerika / Amerikanische Keramische Gesellschaft ACerS
Oulu, Finnland	17./20.6.2007	EMPC 2007 – 16 th European Microelectronics and Packaging Conference & Exhibition	IMAPS Nordic / Europa
München	8./9.10.2007	IMAPS Konferenz 2007	iMAPS D
München	10./11.10.2007	Advanced Packaging Conference	SEMI, IMAPS Europe

und als Papiausdruck zum Preis von



€110,-

erworben werden.

Auch die Proceedings der *Herbsttagung 2006*, die am 10. und 11. Oktober 2006 in München durchgeführt wurde, sind jetzt als CD zum Preis von



€ 55,-

erhältlich.

Richten Sie bitte Ihre Bestellungen an:

Dipl.-Oec. Hans-Ulrich Knipps, c/o Hesse & Knipps GmbH, Vattmannstraße 6, D-33100 Paderborn, Fax: 05251/1560-97, hans-ulrich.knipps@imaps.de

Bitte beachten Sie, dass der angegebene Preis gemäß § 4 Nr. 22 UstG umsatzsteuerfrei ist und die verfügbare Anzahl begrenzt ist.

Internet-Auftritt von IMAPS Deutschland

Sie finden die Webseiten von IMAPS Deutschland im Internet unter

<http://www.imaps.de>

Hier erhalten Sie aktuelle Informationen über Veranstaltungen und Ansprechpartner von *IMAPS Deutschland e.V.* Darüber hinaus können Sie dort auch Ihre Mitgliedschaft beantragen. Über Kritik und Anregungen, aber auch inhaltlichen Input würde sich der Vorstand sehr freuen.

Die internationalen Seiten von IMAPS erreichen Sie unter

<http://www.imaps.org>

oder für Europa:

<http://www.imapseurope.org>

Kontakte und Adressen des IMAPS-Vorstandes

Dr.-Ing. Jens Müller

1. Vorsitzender

c/o ZiK MacroNano

Applikationszentrum Ilmenau

Gustav-Kirchhoff-Str. 5

98693 Ilmenau

Fon: 03677/69-3381

Fax: 03677/69-3379

e-mail: jens.mueller@imaps.de

Dr.-Ing. Gisela Dittmar

2. Vorsitzende

c/o Ingenieurbüro Elektroniktechnologie

Egerlandstraße 88

D-73431 Aalen

Fon: 07361/931129

Fax: 07361/943004

e-mail: gisela.dittmar@imaps.de

Dipl.-Oec. Hans-Ulrich Knipps

Schatzmeister

c/o Hesse & Knipps GmbH

Vattmannstraße 6

D-33100 Paderborn

Fon: 05251/1560-14

Fax: 05251/1560-97

e-mail: hans-ulrich.knipps@imaps.de

Prof. Dr.-Ing. Matthias Fischer

Schriftführer

c/o FH Schmalkalden

FB Elektrotechnik

D-98574 Schmalkalden

Fon: 03683/688-5116

Fax: 03683/688-5499

e-mail: matthias.fischer@imaps.de

Dipl.-Phys. Rolf Aschenbrenner

Öffentlichkeitsarbeit

c/o Fraunhofer Institut Zuverlässigkeit

und Mikrointegration

Chip Interconnection Technologies

Gustav-Meyer-Allee 25

D-13355 Berlin

Fon: 030/46403-164

Fax: 030/46403-161

e-mail: rolf.aschenbrenner@imaps.de

Dipl.-Ing. Thomas Bartnitzek

Öffentlichkeitsarbeit

c/o VIA electronic GmbH

Robert-Friese Straße 3

D-07629 Hermsdorf

Fon: 036601/81-529

Fax: 036601/81-530

e-mail: thomas.bartnitzek@imaps.de

Dipl.-Ing. Paradiso Coskina

Öffentlichkeitsarbeit

c/o VDI/VDE Innovation + Technik GmbH

Steinplatz 1

D-10623 Berlin

Fon: 030/310078-242

Fax: 030/310078-256

e-mail: paradiso.coskina@imaps.de

Dr.-Ing. Karl-Heinz Drüe
Öffentlichkeitsarbeit
c/o TU Ilmenau
Fakultät EI
FG Mikroperipherik
Pf 100565
D-98684 Ilmenau
Fon: 03677/69-3429
Fax: 03677/69-3350
e-mail: karl-heinz.drue@imaps.de

Ernst Eggelaar
Öffentlichkeitsarbeit
c/o Microtronic Microelectronic Vertriebs GmbH
Klein Grötzing
D-84494 Neumarkt-St. Veit
Fon: 08722/9620-0
Fax: 08722/9620-30
e-mail: ernst.eggelaar@imaps.de

Prof. Dr.-Ing. Heinz Osterwinter
Öffentlichkeitsarbeit
c/o FHTE Standort Göppingen
Robert-Bosch-Str. 1
D-73037 Göppingen
Fon: 07161/679-157
Fax: 07161/679-233
e-mail: heinz.osterwinter@imaps.de

Dr. Martin Oppermann
Öffentlichkeitsarbeit
EADS Deutschland GmbH
Microwave Factory / Defence Electronics
Woerthstr. 85
D-89077 Ulm
Fon: 0731/392-3879
Fax: 0731/392-3362
e-mail: martin.oppermann@imaps.de



Na Klar!!

Unsere Werbeanzeige
zur SMT/Hybrid/Packaging
in der Fachzeitschrift „PLUS“.

Schnell Kontakt aufnehmen:

Petra Istvan, Tel. 07581/4801-14,
email petra.istvan@leuze-verlag.de

SMT HYBRID PACKAGING